



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20100308004C
2011 年 2 月 1 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタマドキュメント
マネージャ 牧 達郎 (牧)

HVAL-SLL 8 ピンPWパッケージ 一部製品 組立サイト追加のご案内
(認定済 95 製品からの対象除外 6 製品の連絡)

(第二版 PCN20100308004B 2010 年 5 月 17 日発行, 初版 PCN20100308004 2010 年 3 月 16 日発行)

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しく願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての追加連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではありません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはありません。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30** 日以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)		☒ Final notice	
変更概要	Design/Specification	☐ Design	☐ Electrical	☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	☒ Assembly	☒ Site	☐ Process	☐ Material
	Test	☐ Site	☐ Process	
	☒ Others	☒ Packing/Shipping/Labeling		☐ -
変更内容	下記変更について認定済 95 製品からの対象除外 6 製品の連絡になります。 HVAL-SLL 8 ピン PW パッケージ 一部製品 組立サイト追加 現行 : TI-Malaysia(マレーシア) 変更後 : TI-Malaysia(マレーシア), ASE 社(上海, 中国)			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	—			
品質認定試験	☐ 計画		☒ 終了	
製品表示	☐ 変更無し		☒ 変更あり	
備考	—			

変更内容

内容：今回のお知らせは、下記変更について認定済95製品からの対象除外6製品の連絡になります。弊社 HVAL-SLL (汎用リニアロジック) 8ピンPWパッケージ一部製品の組立サイトについて、現行 TI-Malaysia(マレーシア)サイトにて製造しておりますが、供給能力確保の為に、これに加えて、ASE 社(上海, 中国)サイトを追加し認定しました。組立部材の変更については下記を参照下さい。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容	現行	変更後
組立サイト	TI-Malaysia(マレーシア)	TI-Malaysia(マレーシア) ASE社(上海, 中国)

	現行	追加変更
組立サイト	TI-Malaysia	ASE-Shanghai
チップ接着剤	4042500	EY1000063
モールド樹脂	4206193	EN2000507
リードフレーム(表面処理, 部材)	NiPdAu, Cu	NiPdAuAg, Cu

理由：供給能力確保の為

対象製品リスト

対象製品名 □: 認定終了品 取消線・薄字: 対象除外品				
74CB3Q3306APWRE4	LM358APWRG4	LMV358IPWG4	RC4580IPWR	SN74CBT3306PWRG4
LM2903PW	LM358PW	LMV358IPWR	RC4580IPWRE4	SN74CBTD3305CPW
LM2903PWE4	LM358PWE4	LMV358IPWRE4	RC4580IPWRG4	SN74CBTD3305CPWE4
LM2903PWG4	LM358PWG4	LMV358IPWRG4	SN74CB3Q3305PW	SN74CBTD3305CPWG4
LM2903PWR	LM358PWR	RC4558IPW	SN74CB3Q3305PWE4	SN74CBTD3305CPWR
LM2903PWRE4	LM358PWRE4	RC4558IPWE4	SN74CB3Q3305PWG4	SN74CBTD3305CPWRE4
LM2903PWRG4	LM358PWRG4	RC4558IPWG4	SN74CB3Q3305PWR	SN74CBTD3305CPWRG4
LM2904PW	LM358PWR-JF	RC4558IPWR	SN74CB3Q3305PWE4	SN74CBTD3306CPW
LM2904PWE4	LM393APWR	RC4558IPWRE4	SN74CB3Q3305PWRG4	SN74CBTD3306CPWE4
LM2904PWG4	LM393APWRE4	RC4558IPWRG4	SN74CB3Q3306APW	SN74CBTD3306CPWG4
LM2904PWR	LM393APWRG4	RC4558PW	SN74CB3Q3306APWE4	SN74CBTD3306CPWR
LM2904PWRE4	LM393PW	RC4558PWE4	SN74CB3Q3306APWG4	SN74CBTD3306CPWRE4
LM2904PWRG4	LM393PWE4	RC4558PWG4	SN74CB3Q3306APWR	SN74CBTD3306CPWRG4
LM2904PWR-JF	LM393PWG4	RC4558PWR	SN74CB3Q3306APWRG4	SN74CBTD3306PW
LM358APW	LM393PWR	RC4558PWE4	SN74CBT3306PW	SN74CBTD3306PWE4
LM358APWE4	LM393PWE4	RC4558PWRG4	SN74CBT3306PWE4	SN74CBTD3306PWG4
LM358APWG4	LM393PWRG4	RC4580IPW	SN74CBT3306PWG4	SN74CBTD3306PWR
LM358APWR	LMV358IPW	RC4580IPWE4	SN74CBT3306PWR	SN74CBTD3306PWE4
LM358APWRE4	LMV358IPWE4	RC4580IPWG4	SN74CBT3306PWE4	SN74CBTD3306PWRG4

製品表示

今回の変更に伴い、出荷ラベルに記載の原産地(ラベル箇所:22L)及び製品捺印が下記のようになります。

	組立サイト	組立サイトコード(22L)
現行	TI-Malaysia	ASO: MLA
追加認定	ASE-Shanghai	ASO: ASH



図1 出荷ラベルの例

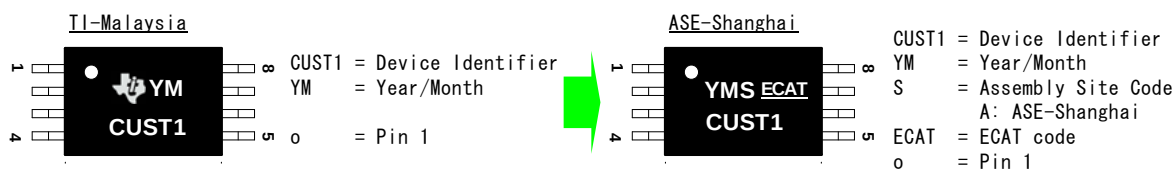


図2 捺印表示の例 (8ピンPWパッケージ)

信頼性試験

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	—	終了	2010 年 4 月 29 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	LM358APW	-	-	
Assembly Site:	ASESH	Package/Code/Pins:	TSSOP/PW/8	
Mount Compound:	EN4900	Mold Compound:	CEL9240	
Bond Wire:	0.8 Mil Dia., Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAuAg, Cu	
MSL:	JEDEC LEVEL-1 /260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Steady-state Life Test	150C, 300 Hours	77/0	77/0	77/0
Electrical Characterization	per spec	Approved	Approved	Approved
**High Temp. Storage Bake	170C, 420 Hours	77/0	77/0	77/0
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hours	76/0	76/0	76/0
**Autoclave	121C, 96 Hours	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C, 500 Cycles	77/0	77/0	77/0
Visual / Mechanical	per spec	Approved	-	-
Solderability	Steam age, 8 Hours	22/0	22/0	22/0
Lead Pull	# of leads to destruction, min. 3 units	22/0	22/0	22/0
Lead Fatigue	# of leads, min. 3 units	22/0	22/0	22/0
Lead Finish Adhesion	# of leads, min. 3 units	15/0	15/0	15/0
Physical Dimensions	Per mechanical drawing	5/0	5/0	5/0
Flammability	Method A – UL94-0	5/0	5/0	5/0
Flammability	Method B – IEC 695-2-2	5/0	5/0	5/0
Flammability	Method C – UL 1694	5/0	5/0	5/0
Bond Strength	76 ball bonds, min. 3 units	80/0	80/0	80/0
Die Shear	-	15/0	15/0	15/0
Manufacturability (Assembly)	per spec	Approved	-	-
**Thermal Shock	-65C/150C, 500 Cycles	77/0	77/0	77/0
Salt Atmosphere	24 Hours	22/0	22/0	22/0
X-ray	Top side only	5/0	5/0	5/0
Moisture Sensitivity	JEDEC L- 1 / 260C	12/0	12/0	12/0
Note: ** Test requires Moisture Preconditioning, JEDEC L-1 /260C				